

中信证券股份有限公司

关于广东利扬芯片测试股份有限公司

2022 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，出具 2022 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与利扬芯片签订《保荐协议》，已明确双方在持续督导期间的权利和义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期及不定期回访等方式了解利扬芯片业务经营情况，对利扬芯片开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	利扬芯片在本持续督导跟踪报告期间未发生按相关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	利扬芯片在本持续督导期间内未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导利扬芯片及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规

序号	工作内容	持续督导情况
		范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促利扬芯片进一步完善公司的治理制度并严格执行
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序和规则等	保荐机构督促利扬芯片进一步完善公司的内控制度并规范运行
9	督促上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分的理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促利扬芯片进一步完善信息披露制度并严格执行，审阅其信息披露文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对利扬芯片的信息披露文件进行事前或事后的及时审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完成内部控制制度，采取措施予以纠正	在本持续督导期间，利扬芯片及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在上述事项的情况
12	持续关注上市公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，利扬芯片及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报告，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，经保荐机构核查，不存在前述应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐	在本持续督导期间，利扬芯片未发生前述情况

序号	工作内容	持续督导情况
	办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求
16	上述公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	在本持续督导期间，利扬芯片不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现利扬芯片存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发技术人员流失的风险

集成电路测试行业属于典型的知识密集型行业，公司要保持持久的竞争力，必须不断加大人才培养和引进力度。目前，与广阔的市场空间相比，专业测试研发技术人员严重匮乏。公司的测试解决方案开发、测试技术创新和前瞻性研究主要依托以核心技术人员为骨干的研发团队。公司测试技术复杂程度高、研发难度大，掌握这些技术需要多学科的知识积累和多年的技术沉淀，如果研发技术人员大量流失，将对公司经营造成重大不利影响。

（二）经营风险

1、公司生产设备折旧年限显著长于可比公司、对经营业绩影响较大的风险

公司生产设备折旧年限为 5-10 年，京元电子机器设备折旧年限为 2-8 年，

华岭股份折旧年限为 3-5 年。公司生产设备的折旧年限显著长于可比公司，主要系公司根据生产设备的预计使用寿命并结合生产使用过程中不存在需要进行大修、替换和报废的情形而综合确定。二手设备折旧年限由公司技术部门综合考虑设备产地、品牌、型号、机械精准度、测试机测量精准度、已使用设备年限情况、磨损新旧程度和设备保养情况综合判断，将折旧年限确定为 5-8 年。若公司对二手设备使用寿命的判断存在重大失误，或二手设备未能达到预期可使用年限，将对公司生产经营状况和经营业绩造成不利影响。

2、公司客户集中度较高、新客户收入贡献缓慢的风险

公司客户的集中度虽在逐年下降，占比仍然较高。如果未来公司主要客户的经营情况发生重大不利变化，或由于公司测试服务质量等自身原因流失主要客户，将对公司的经营产生不利影响。公司与新增客户在合作过程中，需通过工程批、小批量测试验证芯片产品后方可进入量产测试阶段。新增客户的芯片产品能否快速进入量产测试阶段，主要取决于新增客户芯片产品在终端市场推广的程度。若短期内公司新增客户的产品不能有效在市场推广，将延长新增客户的培育周期，使得新增客户对公司收入贡献较为缓慢，可能对公司业绩持续增长造成不利影响。

3、公司销售区域集中的风险

上年度和本报告期，公司主营业务收入来自华南地区收入的比重分别为 68.37%和 62.40%，存在销售区域集中的风险，若华南地区市场环境发生重大不利变化，将对公司业绩带来不利影响。

4、公司发展需持续投入大量资金的风险

集成电路测试行业属于资本密集型行业。为了扩大测试规模，保证充足的产能以满足订单测试需求，提高市场竞争力，公司需不断添置测试机、分选机和探针台等测试平台。如果公司未来不能获取足够的经营收益，或者融资渠道、规模受限，导致资金投入减少，可能对公司的发展和市场竞争力产生不利影响。

5、公司毛利率波动的风险

公司测试的芯片种类和型号较多，使用不同测试平台的毛利率存在一定差异，产品结构、高中端测试平台收入结构的变化将影响公司主营业务毛利率。其次，

公司成本结构中以固定性成本为主，主要包含测试设备折旧、厂房租金和电费等。若公司未来营业收入规模出现显著波动，或流失先进制程芯片测试项目等高毛利率业务，或新增测试设备稼动率较低，公司将面临毛利率波动的风险或无法维持现有毛利率的风险。

6、公司租赁房产产权存在瑕疵的风险

公司向万兴汽配租赁的位于东莞市万江街道莫屋工业区厂房、办公室和宿舍未取得房产证，其产权存在瑕疵。公司承租位于东莞市万江街道莫屋工业区的房屋面积共 25,335.05 m²，包含生产厂房、办公区域和宿舍。该等房屋项下土地为莫屋社区集体所有，并经该集体三分之二以上村民代表同意后出租给万兴汽配，但由于时间相隔较远，文件保存不当，莫屋社区无法提供村民决议签字文件，同时万兴汽配未取得相应的规划及建设许可证书和不动产权证书。

未来如果因村民代表同意出租土地的决议文件缺失而发生争议或者纠纷，或因出租方产权瑕疵、出租方违约或当地政府部门对相关土地进行重新规划而使得相关房产拆迁，则公司的厂房、办公室和宿舍存在被迫搬迁的风险，进而对公司的生产经营带来一定的不利影响，搬迁和临时停工都将造成一定的经济损失。

7、劳动力成本上升风险

随着社会人均薪酬的逐步提高，以及公司为保持人员稳定并吸引优秀人才，公司员工薪酬待遇有可能进一步提高，从而增加人工成本，对公司盈利能力产生不利影响。

8、客户产品保管不善的风险

公司在为客户提供晶圆测试和芯片成品测试服务过程中，需替客户保管被测试的晶圆和芯片，公司承担保管风险。虽公司已建立完善的仓储管理制度，并针对客户产品购买了财产保险以降低风险，但由于晶圆和芯片价值高，存放过程中对温度、湿度等环境要求高，若公司在保管期间因管理不善或其他原因导致晶圆或芯片遗失、毁损的，公司将承担赔偿责任，可能对公司经营业绩产生不利影响。

（三）行业风险

1、公司面临的集成电路测试行业竞争风险

集成电路产业链中存在第三方专业测试厂商、封测一体公司、晶圆代工企业、IDM 厂商和芯片设计公司等模式的厂商涉及了晶圆测试、芯片成品测试业务。其中，晶圆代工企业、封测一体公司和第三方专业测试厂商都能对外提供晶圆测试或者芯片成品测试服务，都是服务于芯片设计公司；而 IDM 厂商和芯片设计公司主要为满足集团内部的测试需求来配置一定的测试产能。各类厂商的主营业务和技术特点各不相同，相比于其他四类，国内第三方专业测试厂商起步较晚，分布较为分散且规模较小。中国台湾地区等境外各类测试厂商占据了主要的市场份额，公司市场占有率较低，面临和境外各类测试厂商竞争的压力。

（四）宏观环境风险

1、新型冠状病毒肺炎疫情对公司造成不利影响的风险

公司所处行业为集成电路行业，下游客户主要为芯片设计公司，终端产品应用领域广阔。目前，本次新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营活动暂不构成不利影响，但不能排除后续疫情变化导致客户终端产品出口受限，市场出现萎缩，进而对公司的生产经营产生不利影响。此外，公司客户及目标客户可能受到整体经济形势波动或自身生产经营的影响，也可能导致公司业务拓展等产生不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2022年1-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	226,232,880.86	159,507,396.83	41.83
归属于上市公司股东的净利润	13,599,237.10	39,632,483.79	-65.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,782,888.15	35,523,276.52	-69.65
经营活动产生的现金流量净额	119,279,143.75	91,193,135.33	30.80
	2022 年 6 月末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)

主要会计数据	2022年1-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,029,244,835.54	1,050,689,997.99	-2.04
主要财务指标	2022 年 1-6 月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.10	0.29	-65.52
稀释每股收益（元 / 股）	0.10	0.29	-65.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.08	0.26	-69.23
加权平均净资产收益率（%）	1.28	3.98	减少 2.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.02	3.57	减少 2.55 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	15.34	10.50	增加 4.84 个百分点

报告期内，公司实现营业收入为 22,623.29 万元，较上年同期增加 41.83%，主要原因系公司坚持加大市场开拓力度，特别是中高端领域客户的开发，客户和产品结构发生变化，在高算力、5G 通讯、微处理器、工业控制等领域测试保持快速增长。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,359.92 万元，较上年同期减少 65.69%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,078.29 万元，较上年同期减少 69.65%。主要原因系报告期内公司 IPO 募集资金较原计划提前使用完毕，处于陆续释放产能的阶段。另外，公司在上海和东莞分别新增一处测试基地并逐步投入试产/运营阶段；公司目前有息负债余额为人民币 20,883.75 万元，较上年同期增长 482.69%；综上，使得公司折旧、摊销、人力、电力等固定制造成本较上年同期大幅增加，以及因实施 2021 年股权激励计划，2022 年 1-6 月份支付费用金额为 1,500.97 万元，导致净利润较上年同期下滑。

报告期内公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少分别为 65.52%、65.52%、69.23%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

报告期内，公司研发费用 3,470.19 万元，较上年同期增加 107.27%，占营业收入比例为 15.34%，公司高度重视研发体系的建设，不断加大研发投入，结合

不同应用领域的芯片测试技术开发需求，积极搭建研发架构，提高研发团队的协同性，增强公司综合研发实力。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、测试平台优势

公司具有数字信号芯片、模拟信号芯片、数模混合芯片、射频芯片等的测试能力，积累了较多的测试平台，相比于国内其他独立第三方专业测试公司，公司测试平台类型较为多样和丰富，可满足市场上不同设计公司的测试需求，目前公司拥有爱德万 V93K、T2K、T5 系列、EVA100，泰瑞达 J750、Magnum，Chroma 33XX 系列，NI STS 系列，Accotest STS8200，Sandtek Astar、Qstar，TEL P12、Precio XL，TSK UF200、UF3000，Epson 8000 系列，Hontech 1028C，Chip Right 8508 等测试设备。

2、本土市场客户资源及服务优势

经过多年的发展，我国本土电子产业成长迅速，已成为电子产品生产制造大国，本土芯片设计企业的技术能力和市场能力迅速发展壮大，成为公司最主要的目标客户群。相对于海外竞争对手，公司一方面更加贴近、了解本土市场，能够快速响应客户需求，提供充分的服务支持，可以稳步占据供应链的关键位置；另一方面，公司与本土电子产品制造企业在企业文化、市场理念和售后服务等方面更能相互认同，业务合作通畅、高效，形成了密切的且相互依存的产业生态链。

由于集成电路行业具有技术含量高等特点，并且集成电路设计企业为了抢占市场先机，通常对测试企业的测试能力、质量管理体系、交期、服务效率等方面有着较为严格的要求。公司作为独立第三方专业测试企业，拥有公正的身份立场，具有较强的服务意识和较高的服务效率，能够全面满足客户对测试公正立场的要求。公司高度重视对客户资源的管理与维护，长期通过参与客户工程技术研讨、进行新产品试验等有效措施加强与客户的互动性，通过测试为客户创造更多价值，提升客户对公司的粘性；同时，基于产能保证、技术保密性和更换供应商的操作成本考虑，这种战略合作一般具备较高的稳定性。因此，公司的客户忠诚度比较

高，为公司业务的持续发展奠定巨大的优势，是公司的核心竞争力之一。

3、贴近集成电路产业链的地缘优势

中国集成电路产业已获得长足发展，在全球产业链中的地位举足轻重，集成电路产业链的晶圆代工制造与芯片封装、电子终端产品分别集中于国内的华东、华南地区，目前中国大陆最主要可量产的晶圆代工基地集中在华东，包括中芯国际、上海华力、华虹半导体、台积电和华润上华等；长电科技、通富微电等是以华东为中心的封装基地，这些企业为国内芯片设计公司提供专业的晶圆代工和封装代工服务。

华南地区主要以深圳、东莞为中心，聚集着如比亚迪、富士康等电子组装基地；另外，以手机为消费电子代表的华为、VIVO、OPPO 等总部设在华南，而且集成电路全国总分销集中在深圳，有助于芯片设计公司快速响应终端市场。

公司分别以粤港澳大湾区（广东省东莞市）和长三角（上海市嘉定区）两个中心建立四个测试技术服务基地，既能毗邻终端客户提供服务，又能贴近前端晶圆和封装实现快速响应。公司多年来持续在独立第三方专业测试领域深耕，具备高质量且高性价比的集成电路测试量产能力，稳定的核心技术团队，辐射上下游的快速响应能力，是核心竞争力的体现。

公司在地理上贴近半导体产业中心，在产品质量、交货速度、个性化支持、售后服务等方面也得到了客户的充分认可。同时，公司拥有贴近半导体产业中心的地缘优势，便于获取高素质研发人才的加盟，处于有利的竞争地位，形成了一定的品牌效应。

4、技术研发优势

公司在行业内具备一定的技术研发优势，拥有较强的自主研发测试方案的能力。高效、专业的测试方案需要企业具备深厚的技术底蕴和经验积累，公司长期致力于测试方案开发，具备在较短的产品开发周期内快速开发出满足市场应用的测试方案的核心开发能力。公司较早实现了行业内多项领先技术产品的测试量产，在给客户提供关键技术测试方案上具有突出表现，为客户抢占市场先机及提升竞争力提供有力保障。

公司已经在 5G 通讯、高算力、工业控制、传感器、物联网、生物识别、金融 IC 卡、北斗导航、汽车电子等新兴产品应用领域取得测试优势，未来公司将加大力度继续布局存储（Nor/Nand Flash、DDR 等）、高算力（CPU、GPU、ISP 等）、人工智能（AI）等领域的集成电路测试。

为了保障公司具备长期的市场竞争力，公司高度重视技术的持续创新。未来，公司将进一步增强研发能力，提升现有核心业务的技术水平，开发更多的新型集成电路测试方案，为客户提供更优质的服务，巩固和扩大自身的竞争优势。

5、人才优势

公司拥有多名在集成电路测试行业从业经验长达十余年的资深技术人员和专业的集成电路测试方案开发团队，构成公司技术研发的核心支柱力量，组建专注于当前和未来集成电路行业先进制程、先进封装和新兴应用的芯片产品做前瞻性测试研究的先进技术研究院。公司研发团队具备扎实的研发功底和经验积累，有利于提升公司的自主创新能力，通过不断开发出更具创新性的测试方案，赢得市场广泛认可，为公司带来更多的业务需求。

公司研发团队能开发基于多种高端测试平台的解决方案，并可实现各平台之间的转换，具备丰富的各种类型芯片产品测试方案的开发经验，包括生物识别芯片测试方案、5G 通讯芯片测试方案、先进制程 AI 计算芯片测试方案、智能传感器芯片测试方案、北斗导航芯片测试方案等。

同时，公司还拥有较强的自动化设备硬件开发团队，公司自主研发设计的条状封装产品自动探针台、3D 高频智能分类机械手等集成电路专用测试设备已运用到公司的生产实践中。其中条状封装产品自动探针台可覆盖电容指纹系列产品、光学指纹系列产品、活体指纹系列产品的测试。3D 高频智能分类机械手能够有效解决先进工艺离散性技术难题。

6、公司与第三方专业测试服务厂商的比较优势

与公司同为第三方专业测试厂商的公司相比。一方面，目前中国台湾存在多家规模较大的专业测试上市公司，如京元电子、矽格、欣铨等，与台湾测试公司相比，公司具有区位和文化优势，目前中国大陆为全球最大的电子产品市场之一，

中国大陆的芯片设计公司也迎来高速成长。由于芯片设计公司需要与集成电路测试公司进行密切地合作，在测试的过程中需要深入沟通具体技术问题，考虑到芯片设计领域的技术保密性，国内越来越多的大型芯片设计公司未来会逐渐将测试需求转向国内，优先选择国内的测试公司；另一方面，公司与国内第三方专业测试厂商相比，由于国内第三方专业测试厂商普遍成立时间较晚，规模较小，公司具有一定的规模优势和市场开拓优势。

7、公司与封测一体公司、晶圆代工企业、IDM 厂商、芯片设计公司的比较优势

（1）与封测一体公司相比：封测一体公司更多专注于封装领域的研发，其测试更多是属于自检，也就是在封装完成后进行配套测试检验，测试的内容主要是芯片的基本电性能测试和接续测试。公司作为独立第三方专业测试公司，专注于测试领域的研发，且多为自主研发测试方案，在测试服务技术实现路径上与封测一体公司存在差异；公司在产业链的位置为独立第三方，仅提供专业测试服务，测试报告更加中立、客观；

（2）与晶圆代工企业相比：独立第三方专业测试公司可选择的测试平台相对较多，具有较高的匹配度，交期也具有明显优势，测试成本相对较低；

（3）与 IDM 厂商相比：独立第三方专业测试可接受订单的范围较广，IDM 厂商一般不接受外部订单，测试产能规划全部服务于集团内部自身设计和制造的产品，相比于 IDM 厂商，公司测试服务客户范围更加广阔；

（4）与芯片设计公司相比：鉴于对商业和技术机密的保护，同类产品的芯片设计公司一般不会将测试需求交付于此种模式的测试厂，因此此类测试厂有业务开展的局限性，扩张潜力不足，产能利用率不高。而公司可与各类设计公司合作，业务开展较广，测试平台稼动率较高。

（二）核心竞争力变化情况

2022 年上半年，公司的核心竞争力未发生重大变化。

七、研发支出变化及研发进展

公司研发投入情况如下：

单位：元

	2022年1-6月	2021年1-6月	变化幅度（%）
费用化研发投入	34,701,931.43	16,742,392.26	107.27
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	34,701,931.43	16,742,392.26	107.27
研发投入总额占营业收入比例（%）	15.34	10.50	4.84
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

报告期内，公司进一步加强创新能力和研发投入，具体专利和软件著作权的进展情况如下：

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	9	1	62	11
实用新型专利	20	16	139	116
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	1	4	19	17
其他	0	0	0	0
合计	30	21	220	144

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 0。2022 年上半年，公司募集资金具体使用和结余情况如下：

单位：万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	47,094.26
截至期初累计发生额	项目投入	46,959.48
	利息收入净额	104.66

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	134.78
	利息收入净额	C2	-104.66
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	47,094.26
	利息收入净额	D2=B2+C2	0
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0
实际结余募集资金		F	0

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
广东利扬芯片测试股份有限公司	中国银行股份有限公司东莞万江支行	693873847628	0	已注销
	中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610800001824	0	已注销
	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	54010078801500001485	0	已注销
上海利扬创芯片测试有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610800001848	0	募集资金专户（已于 2022 年 7 月 27 日注销）
合 计			0	

公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，利扬芯片对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

单位：股

姓名	职务	2022 年初持股数	2022 年 6 月 末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
黄江	董事长	41,343,800	41,343,800	-	-
瞿昊	董事	6,918,400	6,918,400	-	-
黄主	董事	4,362,000	4,362,000	-	-
张亦锋	董事、总经理	47,408	47,408	-	-
辜诗涛	董事、董事会 秘书、财务总 监	1,097,400	1,097,400	-	-
袁俊	董事	160,000	160,000	-	-
郑文	独立董事	-	-	-	-
游海龙	独立董事	-	-	-	-
郭群	独立董事	-	-	-	-
张利平	监事会主席	6,818,400	5,113,800	-1,704,600	个人资金需求
徐杰锋	监事	3,850,000	3,850,000	-	-
邓先学	职工监事代表	15,000	15,000	-	-
卢旭坤	研发部总监	250,000	187,500	-62,500	个人资金需求

截至 2022 年 6 月 30 日，利扬芯片实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结的情形；除上述减持情形外，不存在其他减持的情形。

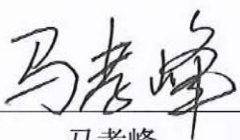
十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

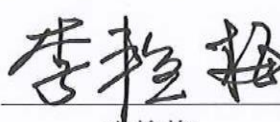
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司
2022 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人:


马孝峰


李艳梅

